

# 深圳市龙图光罩股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

### 暨 2026 年度行动方案

深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“龙图光罩”或“公司”）为认真落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，现将 2025 年度“提质增效重回报”行动方案相关落实暨进展情况报告如下：

#### 第一部分 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况

##### 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售，是具备关键技术攻关能力，拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模版厂商。公司紧跟国内特色工艺半导体发展路线，不断进行技术攻关和产品迭代，形成涵盖 CAM、光刻、检测全流程的核心技术体系，产品广泛应用于信号链及电源管理 IC 等成熟制程，以及功率器件、MEMS 传感器、先进封装等特色工艺制程。

报告期内，公司持续优化深圳工厂的产品结构，快速推进珠海募投项目的建设，全年实现合并报表营业收入 24,665.83 万元，与上年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润 5,608.85 万元，较上年同期下降 38.92%。其中，珠海龙图自 2025 年二季度正式投产，全年实现营业收入 2,728.80 万元，净利润 -1,990.46 万元，尚处于亏损状态。

2025 年，公司收入未能继续保持快速增长，且净利润出现较大幅度下滑，主要原因系：（1）半导体掩模版行业竞争显现，130nm 及以上制程产品竞争加剧，公司针对部分客户进行了策略性降价，导致深圳工厂相应产品收入及毛利率下降；（2）珠海工厂处于产能爬坡关键期，固定资产折旧成本较高，规模效应尚未完全释放，产品毛利率为负；（3）公司重点布局高端制程及关键客户开发，研发投入、销售费用等同比增加明显；（4）珠海工厂采购的原材料中，部分存货可变现净值低于成本，公司基于审慎性原则计提了相应的资产减值损失。

## **（一）优化产能布局：两厂协同发力，加速产能释放**

2025年，面对半导体掩模版行业竞争加剧，以及珠海新厂产能爬坡的阶段性挑战，公司秉持“两厂协同发力，加速产能释放”的目标，积极开展深圳工厂的降本增效和珠海工厂的客户拓展工作，公司整体运营情况保持稳定，并顺利完成珠海工厂投产。

深圳工厂作为公司业务基础，因130nm以上节点产品进入国产替代后期竞争显现，公司通过针对部分客户进行策略性降价巩固市场份额，并持续开展降本增效工作，加强客户服务能力。2025年，深圳工厂虽然出现收入下降、毛利率下降情况，但总体仍保持生产经营稳定。同时，公司对深圳工厂与珠海工厂统一管理，不断优化两厂在原材料调配、客户服务、人员管理方面的协同效应。

珠海工厂作为公司未来增长点，于2025年二季度正式投产，全年实现营业收入2,728.80万元，已进入稳定运营状态。130~65nm节点半导体掩模版以电子束、PSM作为核心技术支撑，下游客户范围更加集中，国产替代目前处于快速推进阶段。珠海工厂快速推进上述节点的客户送样验证，加速产能释放节奏，为承接高端订单、恢复收入增长进行充分准备。

## **（二）紧抓技术攻坚：聚焦高端突破，筑牢核心壁垒**

报告期内，公司持续加大研发投入，坚守突破高端制程的核心战略，聚焦“高端制程突破+全流程工艺优化+国产替代推进”三大方向集中发力，技术研发工作取得显著成效。

深圳工厂持续巩固130nm及以上制程的技术优势，通过全流程工艺优化、版图处理自动化提升，制程报废率进一步降低，零缺陷产品比率进一步提高。珠海工厂则加速高端制程攻坚，在电子束曝光、干法刻蚀、PSM产品技术等方面持续投入，90nm节点产品实现量产，65nm掩模版产品开始送样验证，40~28nm产品已启动项目规划和建设工作。

专利与技术储备方面，公司全年聚焦版图数据处理、OPC补偿、电子束光刻、干法刻蚀等核心技术环节深化研发，获得发明专利4件，实用新型专利4件，软件著作权5件，进一步完善了“CAM-光刻-检测-修补”全流程技术体系，

继续筑牢核心技术壁垒。此外，公司积极响应国家半导体产业自主可控政策导向，结合自身工艺特点推进国产材料替代工作，部分核心材料已开始进行国产替代，一定程度上降低了进口依赖，提升了供应链的自主性与稳定性。

2025年，公司不断强化技术团队建设，继续积极引进行业内及上下游技术人才，进一步储备和充实公司的研发、技术和客户服务队伍；通过MES等信息系统的升级优化，公司继续实施数字化升级和生产运营精益化管理，队伍建设和管理优化的推进，为高端产品技术突破提供了良好支撑。

### **（三）持续客户开拓：稳固存量根基，突破增量赛道**

报告期内，公司深圳工厂以稳定市场份额，策略性降价保障订单为主要市场策略，继续深化客户服务，是公司完成经营目标的基本保障；公司珠海工厂以聚焦重点客户，加速送样验证过程为主要市场策略，成功完成了多家客户的审厂验证工作和新产品送样验证工作，为后续收入增长奠定了良好的基础。

公司深圳工厂以精细化运营深耕存量市场，始终将核心客户深化合作放在首位。2025年，公司不断围绕存量客户需求优化产品体系与服务流程，凭借产品质量的稳步提升与定制化的服务方案，持续增强核心客户合作粘性，同时针对部分客户存在的差异化需求积极开发适配产品，增加公司收入来源。

公司珠海工厂以增量市场及核心客户开拓作为核心抓手，全力推进高端制程认证与突破。2025年，珠海工厂持续完善生产与品质管理体系，顺利通过华虹宏力、燕东微、润西微、三安集成、意法半导体等多家客户的审核认证，其中部分客户已实现小批量合作。珠海工厂客户群体和相关产品持续向高端化拓展，为后续销售规模提升与重大客户体系扩充筑牢了发展根基。

### **（四）提升管理效能：制度适配监管，回报传递价值**

报告期内，公司主动优化治理架构，以适配监管要求与业务发展。2025年10月，公司顺利完成董事会换届并正式取消监事会，将其职能整合至董事会审计委员会，构建了权责更集中的治理架构。同时，公司全面修订了《公司章程》及二十余项核心制度，有效提升了治理规范性与决策效率。

报告期内，公司深入践行“以投资者为本”的理念，通过实质性回报与透明

沟通，积极回馈股东信任，切实落实“提质增效重回报”。2025年，公司实施了2024年度权益分派，现金分红达5,340万元，切实提升了投资者的获得感与长期信心。

公司高度重视投资者关系，通过完善制度、举办业绩说明会，以及上证e互动、投资者热线、ir邮箱及官方平台等多渠道回应投资者关切，保持与市场的有效沟通，积极回应关切并传递公司价值。

## **二、持续加强募投项目管理，提升公司科技创新能力**

2024年8月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币6.17亿元。上市以来，公司使用募集资金投入“高端半导体芯片掩模版制造基地项目”、“高端半导体芯片掩模版研发中心项目”，力求加快项目建设。目前，IPO募集资金使用比例已超过98%。

2025年，公司持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。具体如下：

### **1、高端半导体芯片掩模版制造基地项目**

截至2025年12月31日，高端半导体芯片掩模版制造基地项目累计投入53,167.93万元，累计投入进度为99.67%；公司KrF-PSM和ArF-PSM陆续送往部分客户进测试验证，其中90nm节点产品已实现量产，65nm节点产品已开始送样验证，并已启动40nm-28nm工艺规划和建设。随着上述项目的推进，公司产品下游应用领域也将向驱动芯片、MCU、信号链、CIS、Flash、eNVM等扩展，充分满足下游大型晶圆厂的配套需求，在扩大市场份额的同时，提升公司产品的竞争力。

### **2、高端半导体芯片掩模版研发中心项目**

高端半导体芯片掩模版研发中心项目累计投入金额为1,865.26万元，累计投入进度为93.26%。该项目是对公司现有或未来主要产品及核心技术的进一步开发、升级与创新，公司将通过自筹资金、合作研发等方式，继续增加研发投入，继续保持公司的研发优势，加快更高制程节点产品的转化。

## **三、重视股东回报，共享发展成果**

公司高度重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性，切实让投资者分享公司的发展成果，提升获得感。2025年，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），合计派发现金红利人民币5,340.00万元（含税），占公司2024年度归属于母公司所有者的净利润的58.15%。

2025年，公司为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，根据所处行业状况，结合公司实际业务情况、未来发展规划、资金情况，妥善协调好资本开支、经营性资金需求与现金分红的关系，根据法律法规及《公司章程》《上市后三年内股东分红回报规划》的规定并结合公司实际运营情况进行分红，切实提升股东回报水平，将“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制落在实处。

#### **四、坚持规范运作，优化公司治理**

公司高度重视治理结构的健全和内控体系的有效性，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和监管要求，不断完善公司治理体系。目前，公司已建立由股东会、董事会、和高级管理人员组成的法人治理机构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范、相互协调、相互制衡的公司运作机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。此外，公司构建了一套全面的内部管理与控制体系，覆盖预算管理、销售与收款、采购与付款、对外投资以及关联交易等各个关键环节，从而有效控制了经营风险，促进了公司管理的规范化、运营的效率化。

2025年，公司召开了11次董事会、4次监事会、4次股东会。董事会审计委员会召开了5次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，董事会提名委员会召开了3次，董事会战略委员会召开了1次会议。公司董事会及各下属专业委员会根据上市公司规范运行的各项要求，依法依规开展工作，持续提升公司的规范运作和治理水平，有效发挥了专门委员会的作用，提高了董事会的治理能力。

2025年，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司正在对《公司章程》及相关治理制度进行系统性修订

及制定工作。同时，公司与实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，定期检查大股东、董监高的持股情况，并及时传递新的监管政策与要求，不断强化相关方的责任意识 and 履约意识。

公司进一步加大对“关键少数”履职的支撑保障力度，通过提供履职信息支持、协助组织专题培训、现场沟通等多元化方式，全力协助“关键少数”履职。在信息交互方面，公司确保信息传递的畅通、及时、对称与有效；针对“关键少数”就公司经营情况、监管要求等方面提出的问题，公司以最快速度予以专业回复；同时，高度重视“关键少数”提出的专业意见和建议，将其切实转化为推动公司管理水平提升的重要动力。在规范“关键少数”行为方面，公司严格明确其权利与义务，建立健全监督机制，防止“关键少数”滥用股东权利，切实保护中小投资者的合法权益。

#### **五、提升信息披露质量，强化投资者关系管理**

公司始终高度重视信息披露工作，严格遵守相关法律法规和规范性文件的要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。上市以来，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求开展信息披露业务，维护投资者获取信息的平等性，致力于保障投资者的知情权。为了不断提高信息披露质量，公司将持续提升信息披露义务人的责任意识，积极参与监管部门组织的信息披露专项培训，加强对内幕信息等重点事项的管理，防范信息披露风险。

公司始终高度重视投资者关系管理，不断完善投资者关系管理相关的规章制度，持续优化与投资者的沟通工作，通过公司官网、投资者热线电话、邮箱、上证 e 互动、券商策略会、现场参观、业绩说明会等线上线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通，增强投资者对公司的了解与信任，积极传递公司投资价值。

2025 年，公司完成了 4 次定期报告、35 次临时公告以及相应中介文件等附件的披露，涵盖公司财务报告、募集资金使用、章程及相关制度修订等公司治理事项，保证所披露信息的真实、准确、完整、公开及透明，向资本市场有效传达公司经营情况、财务现状及公司的长期投资价值，切实保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，2025 年，公司召开了 2024 年度业绩说明会，参加了 2025 年半年度科创板半导体设备及材料行业集体业绩说明会和 2025 年第三季度

业绩说明会，针对经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 六、其他

公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的各项内容均在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估。截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等；后续实施过程中，公司将持续关注投资者反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并持续推进方案的落地。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况，及时履行信息披露义务。公司将通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

## 第二部分 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

### 一、聚焦主业提质效，夯实经营发展根基

立足半导体掩模版研发、生产、销售核心主业，针对 2025 年经营中存在的产能释放不充分、毛利率承压、规模效应未凸显等问题，以“两厂协同提效、全链路降本增收”为核心，推动经营质量与盈利能力双提升，力争实现营业收入稳步增长、净利润逐步改善，珠海工厂实现盈亏平衡。

**1. 深化两厂协同运营：**进一步优化深圳、珠海工厂的资源调配机制，实现原材料集中采购、生产计划统一排期、客户服务一体化对接，降低整体运营成本。深圳工厂聚焦 130nm 及以上成熟制程产品的降本增效，通过工艺标准化、生产自动化提升产能利用率，严控产品良率与报废率，力争成熟制程产品毛利率回升；珠海工厂加快 130~65nm 高端制程产能爬坡，提升设备稼动率，稳步扩大制程覆盖，改善盈利能力。

**2. 深耕客户服务，提升品牌与市场影响力：**2026 年，公司以客户需求为中心，提升响应速度、交付能力与技术服务水平，保障稳定供货与新产品快速导入，建立高效对接机制，强化技术协同与工艺匹配，深化与头部晶圆厂、芯片设计公司合作，助力公司在国产替代浪潮中继续保持先机；同时，公司将加大对境外优质客户的开拓力度，提升品牌认可度与影响力，积极通过代理、经销、直接合作等多种方式，增加境外销售收入，扩大客户覆盖规模。

**3. 严控成本与资产减值风险：**建立全流程成本管控体系，从原材料采购、生产制造、物流配送等环节压降成本；加强存货管理，结合珠海工厂生产计划精准制定采购策略，减少存货跌价损失，审慎计提资产减值，提升资产运营效率。

**4. 提升资金使用效率：**合理统筹经营资金、募集资金与自筹资金，严控非经营性资金支出，优化资金结构；针对募投项目剩余资金，严格按照监管要求规范使用，确保资金投向与主营业务及高端制程研发紧密相关，提升资金回报率。

## 二、培育新质生产力，强化核心技术与创新能力

紧扣半导体产业自主可控与高端化发展趋势，以“高端制程突破、全流程技术优化、国产替代深化”为方向，加大研发投入、加快创新成果转化、加强人才梯队建设，筑牢技术壁垒，推动公司向更高制程掩模版领域突破，打造新的业绩增长点。

**1. 聚焦技术攻关，强化核心研发能力：**2026年，公司将持续加大研发投入，围绕高精度图形补偿、缺陷检测与控制、先进光刻工艺等关键技术进行研发攻关。公司将依托研发中心平台，深化与产业链上下游的协同创新，完善从材料、工艺、品质到生产管理的全流程技术体系，提升良率与稳定性。公司将加快向更高精度、先进节点迭代，巩固在独立第三方掩模版厂商中的技术优势，支撑产品结构向高端化升级。

**2. 深化国产材料与设备替代：**响应国家半导体产业政策，持续推进核心原材料、关键生产设备的国产替代工作，扩大国产材料的使用比例，降低进口依赖；与国内优质材料、设备供应商建立长期合作机制，联合开展适配性研发，提升供应链的自主性、稳定性与成本优势。

**3. 强化人才队伍与数字化建设：**继续引进行业内高端研发、工艺及客户服务人才，完善核心技术人才的激励与留存机制，打造专业化、复合型的技术团队；持续升级MES等信息系统，深化生产运营精益化管理，推动生产、研发、销售全链路数字化，提升运营效率与决策科学性。

## 三、规范公司治理，提升治理效能与合规水平

以新《公司法》及科创板监管要求为准则，持续优化治理架构、完善内控体系、强化“关键少数”责任，构建权责清晰、运作规范、监督有效的公司治理机制，切实保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

**1.完善治理架构与制度体系：**依托 2025 年董事会换届及职能整合的治理架构，进一步明确董事会各专门委员会的权责边界，提升审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的履职效率；完成《公司章程》及二十余项核心制度的系统性修订，确保制度体系与监管要求、公司业务发展相适配，完善决策流程，提升决策效率。

**2.强化内控体系建设与执行：**持续优化覆盖预算管理、销售与收款、采购与付款、对外投资等关键环节的内控体系，定期开展内控自查与专项审计，及时发现并整改内控缺陷；加强对全资子公司珠海龙图的内控管理，实现母子公司内控体系一体化，有效防控经营与管理风险。

**3.压实“关键少数”履职责任：**加强对控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”的监管与培训，及时传递最新监管政策与要求，强化其合规意识与履职能力；建立“关键少数”履职考核机制，将履职情况与薪酬、激励挂钩，防止滥用股东权利，确保其切实维护公司与中小股东利益；引导“关键少数”通过合理方式传递对公司发展的信心，提升市场认可度。

**4.规范股东会、董事会运作与信息传递：**严格按照法律法规及公司制度召开股东会、董事会及各专门委员会会议，确保会议召集、召开、表决程序合法合规；完善内部信息传递机制，确保公司经营、研发、财务等重要信息在“关键少数”之间畅通、及时、对称，为科学决策提供支撑。

#### **四、提升投资者回报，构建长期稳定的回报机制**

牢固树立“以投资者为本”的理念，结合公司经营发展情况、资金需求与股东诉求，完善利润分配政策，丰富投资者回报方式，提升分红的稳定性、及时性与可预期性，切实增强投资者的获得感与长期信心。

**1.完善中长期股东回报规划：**结合公司上市后三年内股东分红回报规划，进一步细化利润分配决策程序，明确现金分红、送转股等分配方式的适用情形；建立股东回报与公司经营业绩联动机制，根据公司盈利水平、发展阶段动态调整分红方案，提升分红的可预期性。

**2.探索多元化投资者回报方式：**在符合法律法规及监管要求的前提下，结合公司市值情况与发展需求，探索股份回购、增持等多元化回报方式，若出现股价不合理下跌等情形，及时启动稳定股价预案，维护公司市值稳定与股东利益；合

理安排分红时间，提升分红的及时性，增强投资者体验。

## **五、强化投资者关系管理，提升信息披露质量**

严格遵守信息披露相关法律法规，持续提升信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性；丰富投资者沟通渠道，完善投资者意见征询与反馈机制，提升公司透明度，增进投资者对公司的了解与信任。

**1.提升信息披露规范化水平：**严格按照科创板信息披露要求，及时、准确披露定期报告、临时公告及其他重大信息，重点做好研发进展、产能释放、客户合作、募投项目实施等投资者关注事项的信息披露；加强信息披露义务人培训，提升信息披露质量，防范信息披露风险，切实保障投资者的知情权。

**2.丰富多元化投资者沟通渠道：**持续通过上证 e 互动、投资者热线、ir 邮箱、公司官网等线上渠道及时回应投资者关切；线下定期举办业绩说明会、投资者接待日，积极参与券商策略会、科创板行业集体业绩说明会等活动，推动公司董事长、总经理等核心管理层主动与投资者沟通，传递公司经营策略与长期投资价值。

**3.建立投资者意见征询与反馈机制：**主动通过多种渠道收集投资者对公司经营发展、分红政策、信息披露等方面的意见与建议，及时组织相关部门研究落实，并通过适当方式向投资者反馈，形成“征询-落实-反馈”的闭环管理，提升投资者参与度与认同感。

**4.优化信息披露与沟通形式：**采用图文结合、简明解读等方式提升公告可读性，对定期报告、重大项目进展等核心信息制作简明版解读材料；针对半导体行业专业性强的特点，通过行业科普、技术解读等形式，帮助投资者更好理解公司业务与行业发展趋势。

## **六、加强募投项目收尾与管理，实现项目预期效益**

针对公司 IPO 募投项目“高端半导体芯片掩模版制造基地项目”“高端半导体芯片掩模版研发中心项目”已进入收尾阶段的现状，严格按照监管要求与项目规划，做好募投项目剩余工作，加快项目成果落地，确保募投项目实现预期效益，推动公司产品升级与产能提升。

**1.完成募投项目收尾工作：**加快高端半导体芯片掩模版制造基地项目剩余建设内容，推进高端制程半导体掩模量产工作；推进高端半导体芯片掩模版研发中心项目的收尾与验收，充分发挥研发中心的技术支撑作用。

**2.加快募投项目成果转化：**依托募投项目建成的产能与研发平台，公司将全面推进珠海基地产能爬坡，提升 90nm 掩模版供货量，实现规模效应，增加收入规模的同时，降低单位成本以改善盈利状况。同时，公司将加快实现 65nm 掩模版验证通过及小批量供货，提升高端掩模版配套能力，将募投项目的技术成果与深圳工厂的成熟制程工艺相结合，实现技术互补与协同升级，提升公司整体产品竞争力。

**3.规范募投项目资金管理与信息披露：**严格遵守募集资金管理制度，做好募投项目剩余资金的使用与管理，确保资金专款专用；及时披露募投项目实施进展、资金使用情况、成果转化情况等信息，接受投资者与监管部门的监督。

## 七、其他事宜

公司将继续聚焦主业发展，着力提升核心竞争力。通过稳健的业绩表现和规范的公司治理，积极回报投资者信任，切实履行上市公司责任与义务，维护公司良好的市场形象，助力资本市场平稳健康发展。本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

深圳市龙图光罩股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日